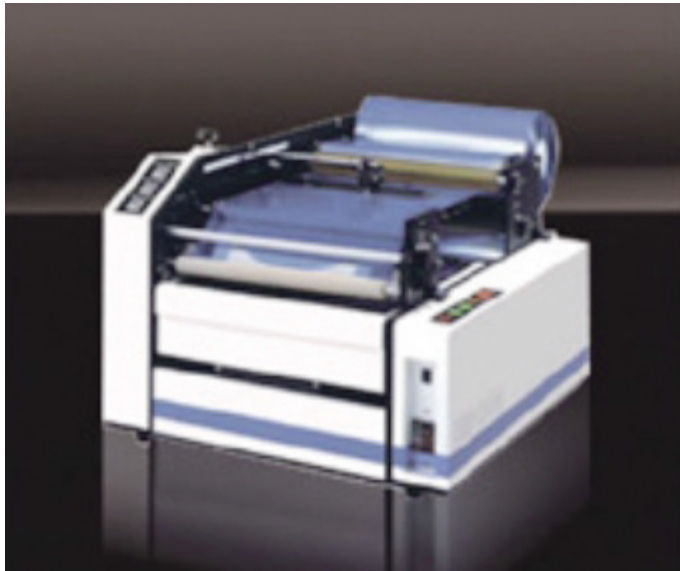


200mm半自动晶圆贴合机

# RAD-2500m/8



## 规格

额定电源	供电电压	: AC100V±10%
	频率	: 50/60Hz
	位相	: 单相
气源	功耗	: 0.2kW
	供气压力	: 0.5-0.8MPa
	耗气量	: >150L/分钟 (ANR)

## 适用的晶圆尺寸

200mm  
如果其他晶圆尺寸或形状需求, 敬请咨询。

## 尺寸

机台宽度(W) : 568mm  
设备纵深(D) : 850mm  
贴膜工作台完全推出时最大长度: 1190mm  
设备高度(H): 527mm

## 重量

90kg

## UPH

18秒/片 (晶圆放置时间除外)

## 概述

由操作员放置晶圆与晶圆环来进行贴膜的半自动晶圆切割胶带贴合机, 使用预切切割胶带。

- 选配功能**
- 静电消除器
  - 顶部防护罩
  - 晶圆定位销

- 适用的胶带**
- 预切切割胶带 “Adwill D系列”、“Adwill G系列”
  - 粘晶切割胶带 “Adwill LE胶带”

## External View

